



## 技术动态

### 解决方案精选

- 10 Digi i.MX53: 高端网络连接模块
- 12 ConnectCore解决方案
- 15 OS81110: MOST智能网络接口控制方案
- 19 MSP430FR59x: 超低功耗嵌入FRAM MCU开发方案
- 24 RN4020: 低功耗蓝牙4.1兼容模块解决方案

### 全球IC新品指南

- 26 月度新品总汇

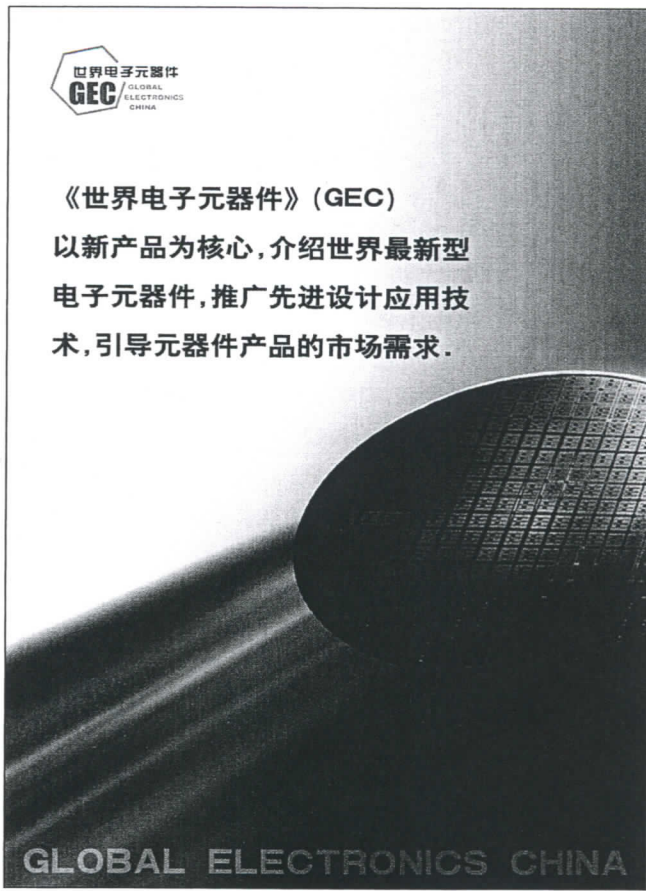
### 电子百科

### 在线座谈精华

- 34 智能电网馈线终端单元解决方案

### 业界访谈

- 48 创新的智能能源管理: 边缘节点+网关+云端的完整方案
- 39 DIALOG: 蓝牙智能芯片打破互联功耗壁垒
- 42 协同合作拓展无线充电市场



《世界电子元器件》(GEC)  
以新产品为核心,介绍世界最新型  
电子元器件,推广先进设计应用技  
术,引导元器件产品的市场需求.

- 莱迪思iCE40 Ultra和ECP5: 满足多功能、  
灵活性设计需求 43
- TI: 打造更安全、更环保、更智能的  
电机驱动器 44
- Advantest: 经典平台添加新模块, 满足更高  
测试需求 46
- 是德科技推出用于新型材料研发的高性能毫  
微微安计/皮安计和静电计 47

### 市场趋势 48

CONTENTS